

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2025-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（投资者线上交流）
参与单位名称及参会人员姓名	中信证券 陈旺 中新创融 翁聘、张禾 信达资本 万毅 太平洋自营 赵子行	
会议时间	2025年12月25日	
会议地点	现场会议	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 杨春雷 首席市场官 柳清超 首席财务官 王琛 证券事务代表 赵润欣	
会议内容	<p>一、请介绍公司概况与战略布局</p> <p>答：西安奕材自设立之初就制定了15年的远期战略规划，计划通过2-3个基地投资建设若干座现代化12英寸硅片工厂，最终成为12英寸硅片领域头部企业。西安是公司的第一基地，现已建成两座工厂，设计产能均为50万片/月。公司第一工厂于2018年动工建设，2023年第一工厂实现50万片/月规划产能达产，位居中国12英寸大硅片领域第一。第二工厂于2022年启动建设并于2024年实现投产，第二工厂进行了差异化产品布局，加大了用于逻辑芯片的外延片以及用于新能源汽车等领域的功率和模拟芯片所用特色工艺硅片的比例，预计2026年年底可实现达产。</p> <p>公司通过西安基地已实现国内几乎所有主流晶圆厂核心工艺平台产品全覆盖，国际头部客户持续深化合作中。在此基础上，2025年12月19日，公司股东会审议通过了在武汉建设第三工厂的议案。第三工厂战略布局武汉主要系为华中及周边客户的战略扩产提供配套服务。</p> <p>二、2025年公司整体出货量预计是多少？正片销售中逻辑与存储的占比是多少？公司如何看待明年的出货情况，包括正品比例，不同产品的比例？</p> <p>答：公司2025年基本实现了出货目标，稼动率处于较高水平。从产品出货角度统计，大部分为用于存储芯片领域的抛光片产品。随着第一工厂效能的不断提升及第二工</p>	

厂达产，公司预计 2026 年的出货量将继续保持增长，公司的产品结构将进一步优化，正片包括高端测试片比例将提升至 70%以上，海外销售规模将继续增长，产品结构及客户结构的优化将促进平均销售价格优化。

三、公司下游客户明年的意向需求如何？

答：1、市场复苏，需求稳步增长：2022 至 2024 年，全球半导体行业经历周期性调整，市场需求承压，2025 年半导体市场逐步进入上升周期。截止 2025 年 12 月，半导体市场收入接近 7700 亿美元，增长率超 20%。公开数据显示，预计到 2026 年中国大陆地区 12 英寸晶圆厂量产数量超过 70 座，相应产能增长至 321 万片/月；全球 12 英寸晶圆厂量产数量将达到 230 座，伴随全球规划的晶圆厂逐步量产，将提升对 12 英寸硅片的需求，12 英寸硅片的头部效应不断显现。

2、AI、新能源汽车、数据中心等新应用的推广对芯片带来新技术迭代，有望为 12 英寸硅片带来新增长点：新产品、新技术催生 12 英寸硅片更多消耗，以公司目前已经送样的高带宽内存（HBM）产品用抛光片为例，同等存储容量的 HBM 对 12 英寸硅片的需求量是目前主流 DRAM 产品的 3 倍。随着 NAND Flash 堆叠层数提升至 200 层、300 层，甚至 400 层，晶圆厂需要通过 2 片甚至更多晶圆键合制作 1 个 NAND Flash 完整晶圆的工艺，相当于 12 英寸硅片需求翻倍甚至更多。

四、如何看待明年整体硅片的价格走势？公司未来计划如何拓展海外客户？

答：从行业情况预计，硅片行业 2025 年逐步进入上升周期，从公司情况预计，伴随公司第二工厂满产，公司产品结构包括正片比例、客户结构等将不断改善，公司平均单价有望提升。

公司设立之初就制定了立足国内，更放眼全球客户的市场策略，坚持与全球头部“老师级”客户合作，不断发现自身的缺陷与差距，以便更加精准和快速地提升与突破。目前公司已经与多家海外头部客户建立了较为稳定的合作关系，未来会持续深化提升。

五、未来美国的关税政策对公司是否有影响？

答：目前美国本土销售会受到一定关税政策影响，但因美国本土晶圆厂产能较小，对公司影响可控。

六、公司第二工厂何时实现 50 万片满产？公司在 2027 年能否实现盈亏平衡？

答：公司第二工厂计划 2026 年底实现 50 万片/月满产，预计 2027 年可实现合并报表盈利。

七、公司产品技术与质量与海外头部企业主要差距在哪里？

答：公司作为国内 12 英寸硅片头部厂商，目前存储芯片用抛光片产品与全球头部企业水平相当，可与全球头部企业供应相同制程芯片用抛光片产品，但需清醒认识到，在深层次技术及品质指标方面，全球头部客户仍具备深厚的技术及工艺储备；逻辑芯片

用外延片产品虽已取得长足进步但与全球头部企业具有一定差距；测试片产品与全球头部企业不存在技术代差。